

Plaskon NXG-1

Epoxy; Epoxide

Cookson Electronics - Semiconductor Products

Описание материалов:

This material is an epoxy molding compound for high temperature, lead-free reflow. It is designed to withstand more demanding requirements in moisture performance, occasioned by the higher IR reflow temperatures required for processing lead-free packages. It is a highly filled, hybrid resin developed to pass JEDEC Level 2A at 260°C IR reflow temperature. It is a "green" compound with no halogens and a lower Tg than multifunctional materials.

Главная Информация			
Характеристики	Полупроводникового Низкое (до по) Содержание свинца Низкая гигроскопичность Ускоренная Настройка Хорошая производительность формования Теплостойкость, высокая		
Формы	Жидкость		
Метод обработки	Литье из смолы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.00	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль			ASTM D790
22°C	2.55	MPa	ASTM D790
260°C	0.0686	MPa	ASTM D790
Flexural Strength			ASTM D790
22°C	0.0125	MPa	ASTM D790
260°C	8.14E-4	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	140	°C	ASTM E1356
CLTE-Поток	8.9E-6	cm/cm/°C	ASTM D696
Теплопроводность	0.70	W/m/K	ASTM C177
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость (3.18 mm)	V-0	UL 94	
Дополнительная информация			

Recommended Storage Temperature: <5°C Life @ 5°C, defined as not more than 40% loss of spiral flow based on original values.: 6 months Life @ 22°C, defined as not more than 40% loss of spiral flow based on original values.: 2 days Life @ 35°C, defined as not more than 40% loss of spiral flow based on original values.: 0.5 days Spiral Flow, 175°C, 1000 psi: 140 cm Shimadzu Viscosity, 175°C, 1000 psi: 40 poise Ram Follower Gel Time, 175°C, 1000 psi: 18 sec Ash Content: 88.6 % Hydrolyzable Halides: <1 ppm Moisture Absorption, 85°C/85%RH, 168 hrs: 0.265% Cull Hot Hardness, Shore D: 75 All test specimens are transfer molded and post cured for 4 hours at 175°C

Linear Thermal Expansion, Alpha 1: 8.9 cm⁻⁶/cm/°C

Linear Thermal Expansion, Alpha 2: 36 cm⁻⁶/cm/°C

Инструкции по впрыску

Resin Transfer Molding:

Molding Temperature: 165 to 185°C

Molding Pressure: 1000 psi

In Mold Cure Time: 50 to 100 sec

Post Mold Cure Time, 175°C: 0 to 2 hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat